



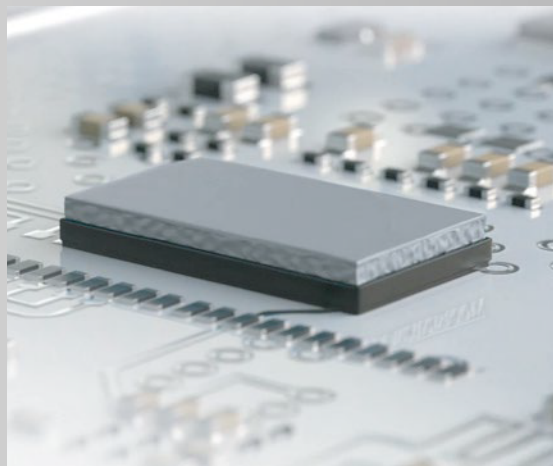
BERGQUIST GAP PAD® TGP 12000ULM

高导热、超低模量导热垫片

BERGQUIST GAP PAD® TGP 12000ULM是为满足超大规模和云规模数据中心的高功率密度设计研发的一款产品，是一款高导热、超低模量的界面导热材料（TIM），非常适合现代的数据通信应用。在目前市场上高性能TIM产品之中，BERGQUIST GAP PAD TGP 12000ULM结合了高达12.0 W/m-K的导热性能与柔软顺应性，确保出色的界面湿润性能，以优化导热性能、实现低装配应力。BERGQUIST GAP PAD TGP 12000ULM是基于硅基树脂研发，其独特的填缝能力可以在提供出色的导热能力的同时降低对元器件的应力。

关键优势

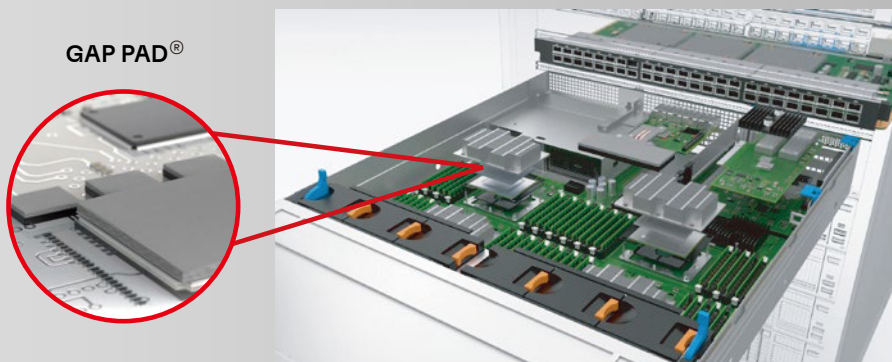
- 超低68硬度 (shore 000, ASTM D2240) 和103杨氏模量 (kpa, ASTM D575) , 确保超低应力
- 在粗糙、不规则表面上具有优秀的顺应共形性能
- 表面上优异的湿润能力, 最大化热传导性能
- 高达12.0 W/m-K (ASTM D5470) 导热性能
- 简化应用与过程; 以预切割的方式供应, 双面高附着力的定制尺寸垫片
- 同款垫片可以用于多种高度的芯片与/或多个设备
- 室温储存



产品特性	BERGQUIST GAP PAD® TGP 12000ULM
硬度 (Shore 000)	68
表面粘性	2
导热系数 (W/m-K)	12
杨氏模量 (kpa)	103
介电击穿电压: 0.04英寸样品 (VAC)	6,200
外观	灰色

典型应用

- 通讯 (路由器, 交换机, 基站)
- 光学收发器
- ASIC和DSP
- 电源模块等高导热应用场景



**Across the Board,
Around the Globe.**
henkel-adhesives.com/electronics



汉高北美
14000 Jamboree Road
Irvine, CA 92606
US
+1.888.943.6535

汉高欧洲
Nijverheidsstraat 7
B-2260, Westernlo
Belgium
+32.1457.5611

汉高亚太
中国上海市杨浦区江湾城路99号
尚浦中心7幢 200438
+86.21.2891.8000